



CCP Contact Probes

股票代號: 6217

2024年中國探針(股)公司法人說明會

2024.11.13

本簡報係建立於本公司從目前各項來源所取得之資訊，部分資訊可能受未來不確定性因素影響，造成預期狀況與實際狀況有所差異，若實際狀況與本公司對於未來前景說明有差異，或有變更或調整時，請以公開資訊觀測站公告資訊為依據。

**01**

公司概況

公司沿革/全球據點

02

產品應用

產品應用/市場趨勢

03

經營績效

營收狀況/產品占比

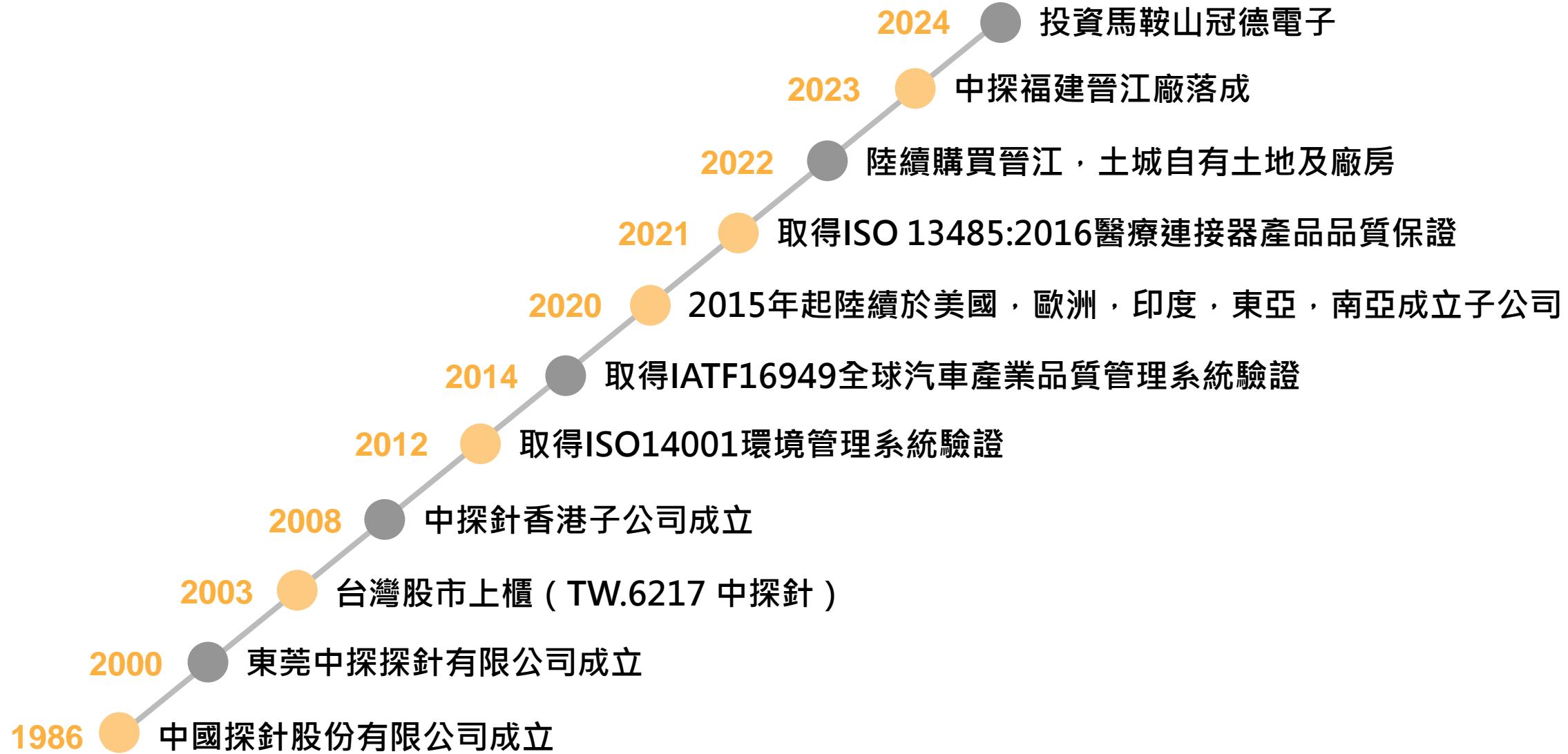
04

未來展望

產品趨勢/產品展望



公司概況



晉江生產基地 - 福建集成電路產業科技園區



概覽

始建於2022年7月，2023年10月正式投產

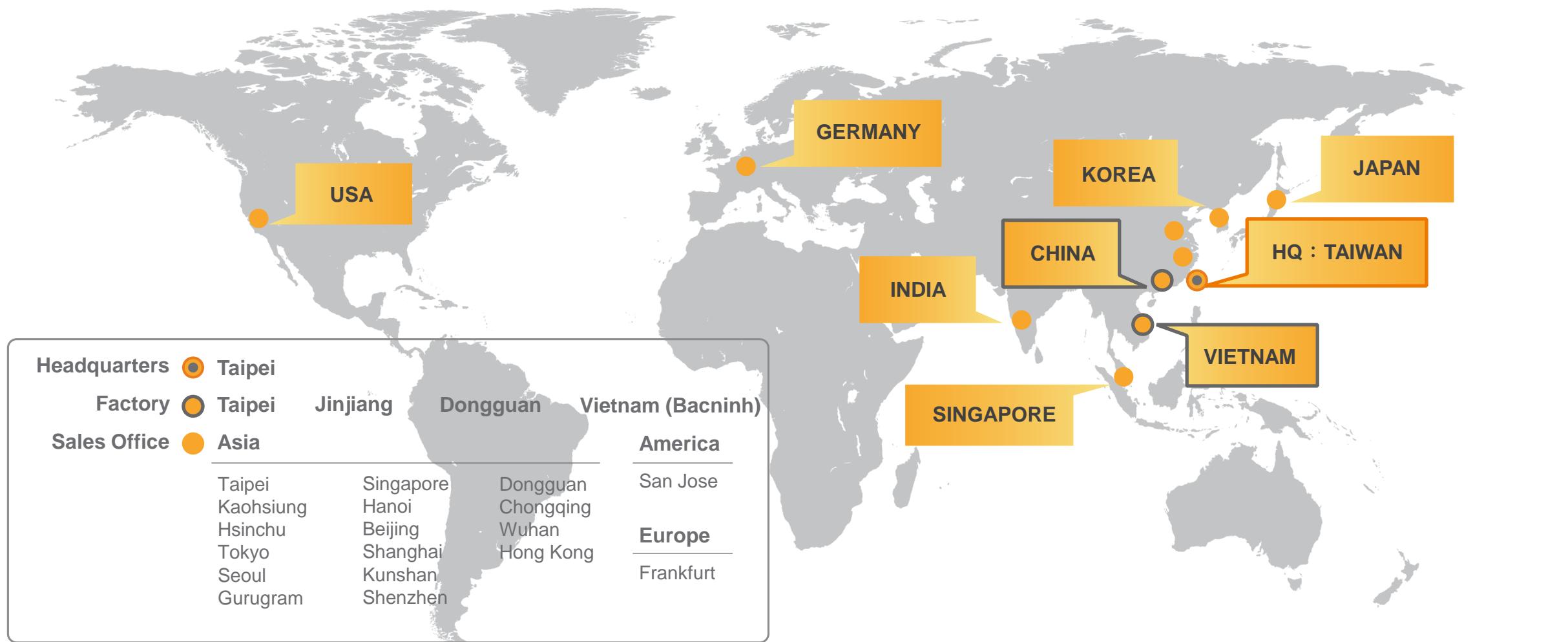
產品類型	新能源產品，連接器，測試探針，大電流針，醫療產品，工業產品	
生產能力	連接器：8000萬 pins/month； 測試探針：200萬 pins/month； 大電流產品：60萬 pins/month	
廠房面積	27000 m ²	
雇員	當前 650 人，計畫2025年擴充至800人規模	
地址	福建省晉江市建興路393號	
樓層信息	#1 Building	#2 Building
1 st Floor	IQC, 倉庫	注塑車間
2 nd Floor	CNC車銑複合車間	精密加工車削中心
3 rd Floor	大電流應用產品線	連接器組裝車間
4 th Floor	測試類產品線	拉伸管&彈簧車間
5 th Floor	Pogo產品線	預留產能擴充車間

品質管制體系資質

IATF 16949:2016、ISO 045001、ISO 14001:2015、IECQ QC080000
ISO 13485、IS014064、ISO 9001:2015



全球據點





產品應用



High Current Connector

13A~250A

Electronic Vehicle
High Current Conn.



Pogo Pin Connector

1A~13A

Pogo Pin Conn.
Waterproof Conn.
Magnetic Conn.

Ready For

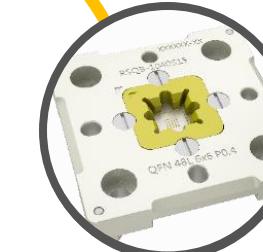
AI

Generation

Testing Solution

Fine Pitch

IC Testing Probe
PCB Testing Probe
Testing Socket



Medical Connector

Environmental Sensitivity

Circular Conn.
Endoscope Conn.



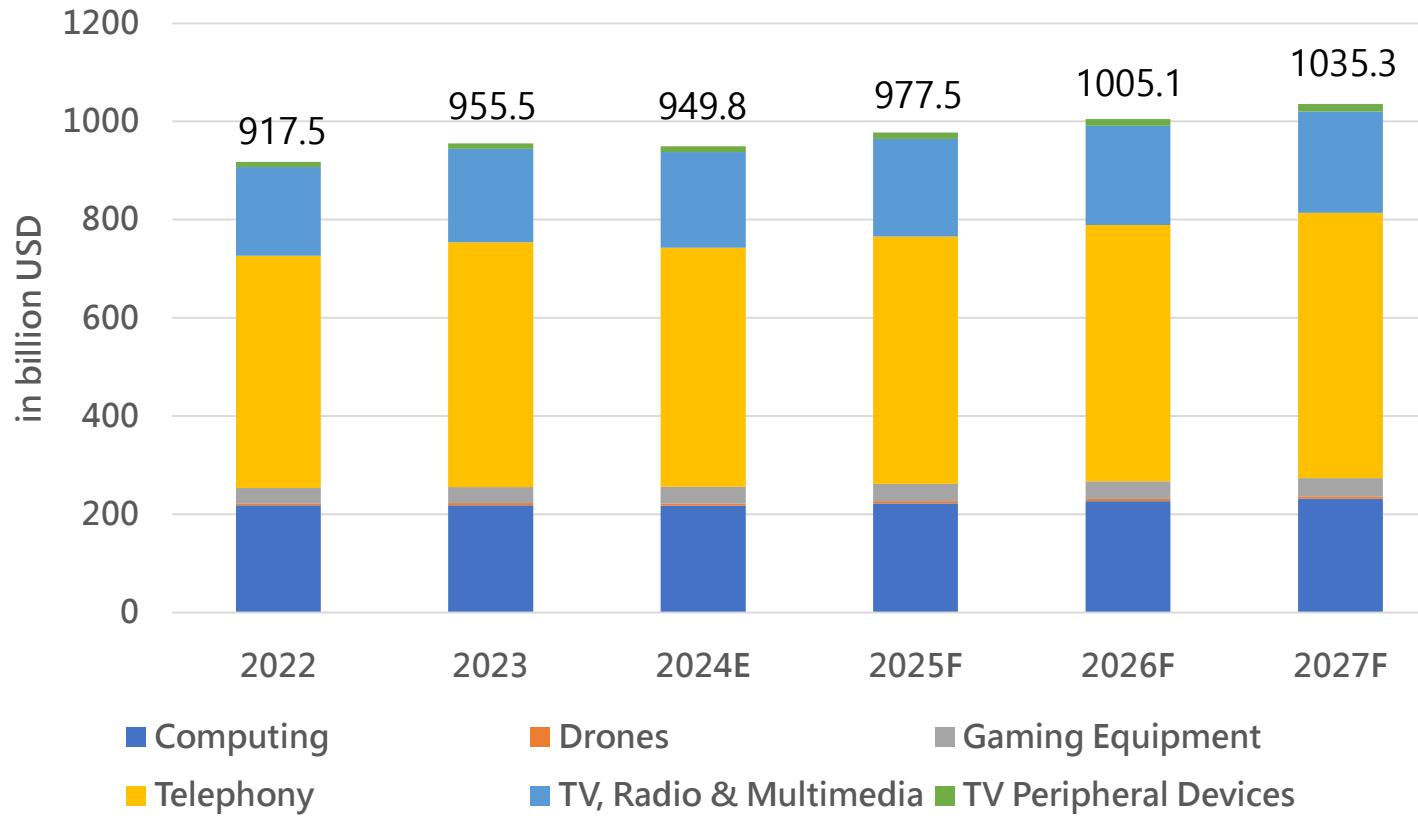
Magnesium Alloy

Lightweight, environmentally friendly & recyclable

NB PC/tablet, E-book appearance & structural parts
Projector/Mobile phone/VR Frame
Medical products/vehicle applications



產業趨勢- 全球消費電子市場持續增長



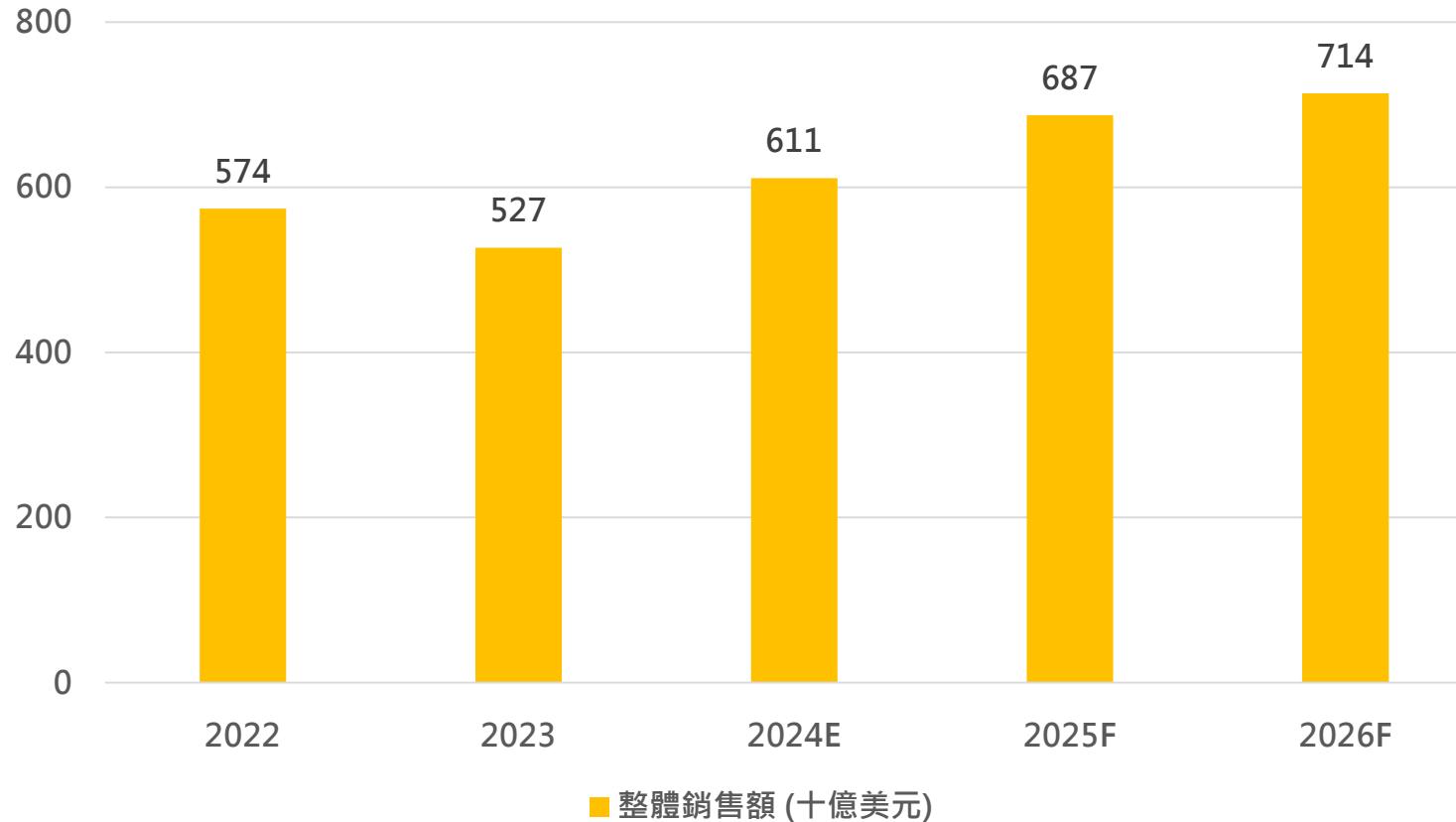
2024-2027 CAGR

+2.9%

- ✓ 根據市調機構Statista報告指出，2024年全球消費市場規模將達約9500億美元。
- ✓ 消費性電子市場最大的細分市場是電話(包括智慧型手機、功能手機與固定電話等)，2024年市場規模將達到4,867億美元。
- ✓ 隨著生成式AI的熱潮，內建AI的智慧型手機與AI PC(含NB)將迎來另一波換機潮，還有AI穿戴式裝置、AI物聯網裝置等商機。



產業趨勢- 全球半導體市場需求



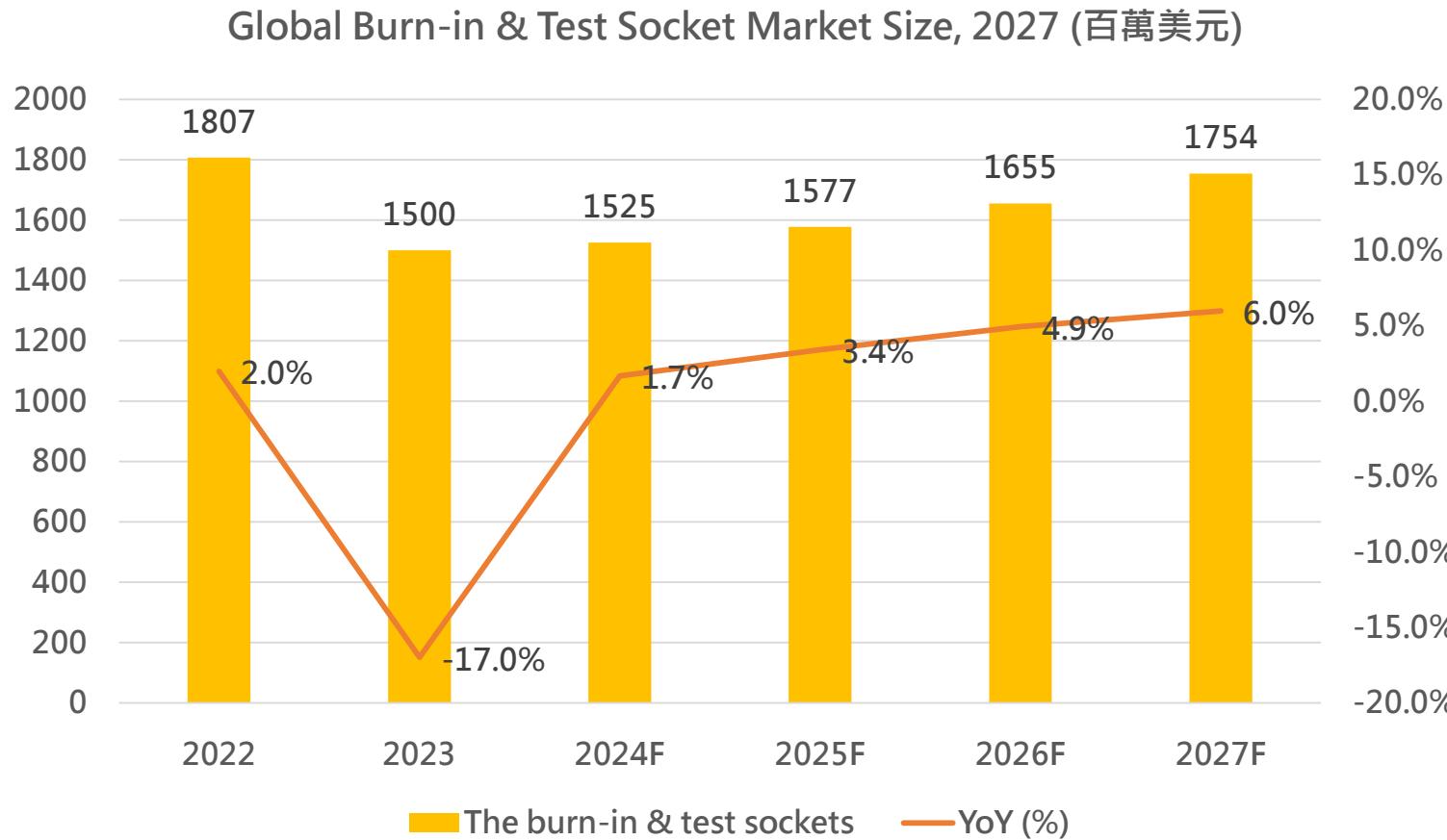
2024-2026 CAGR

+8.1%

整體半導體市場：

- ✓ 產品應用類型為半導體IC (記憶體IC、微元件IC、邏輯IC、類比IC) 及主要供應鏈潛在客戶為晶圓廠 /design house/封測廠/實驗室。
- ✓ 隨著生成式AI的熱潮，內建AI的智慧型手機、AI PC (含NB)、AI穿戴式裝置、AI機器人與自駕車等對於先進半導體產品的需求將持續增長，對應產品需求提升Coaxial socket及High power Burn-in socket的需求。

產業趨勢- 全球半導體測試介面市場需求

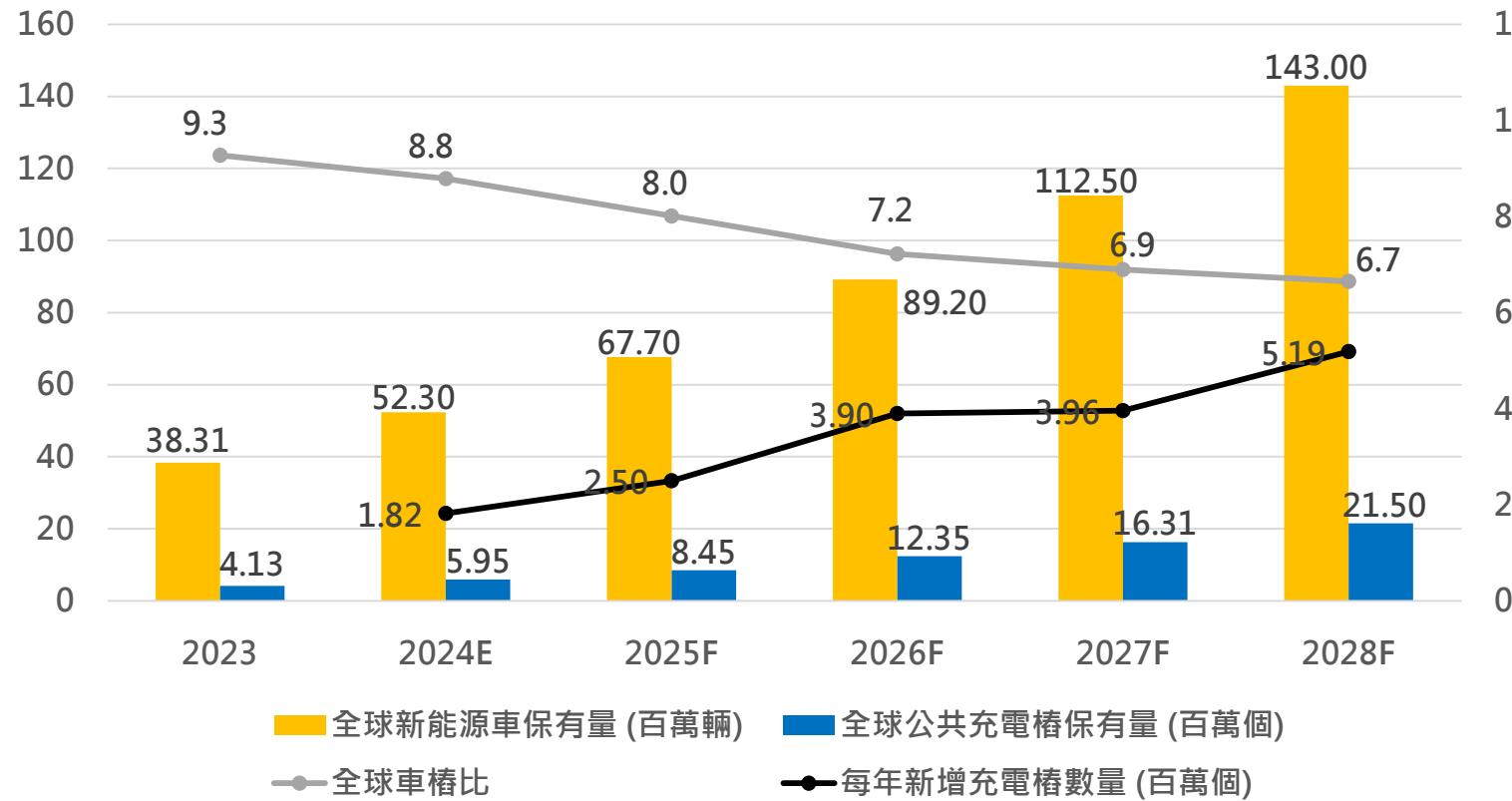


2024-2027 CAGR

+4.8%

- ✓ 根據國際市調機構Yole的預估，2023年全球半導體測試插座市值為15億美元，預計2027年將達17.5億美元，2024-2027年CAGR為4.8%。

產業趨勢- 全球新能源車與公共充電樁市場需求

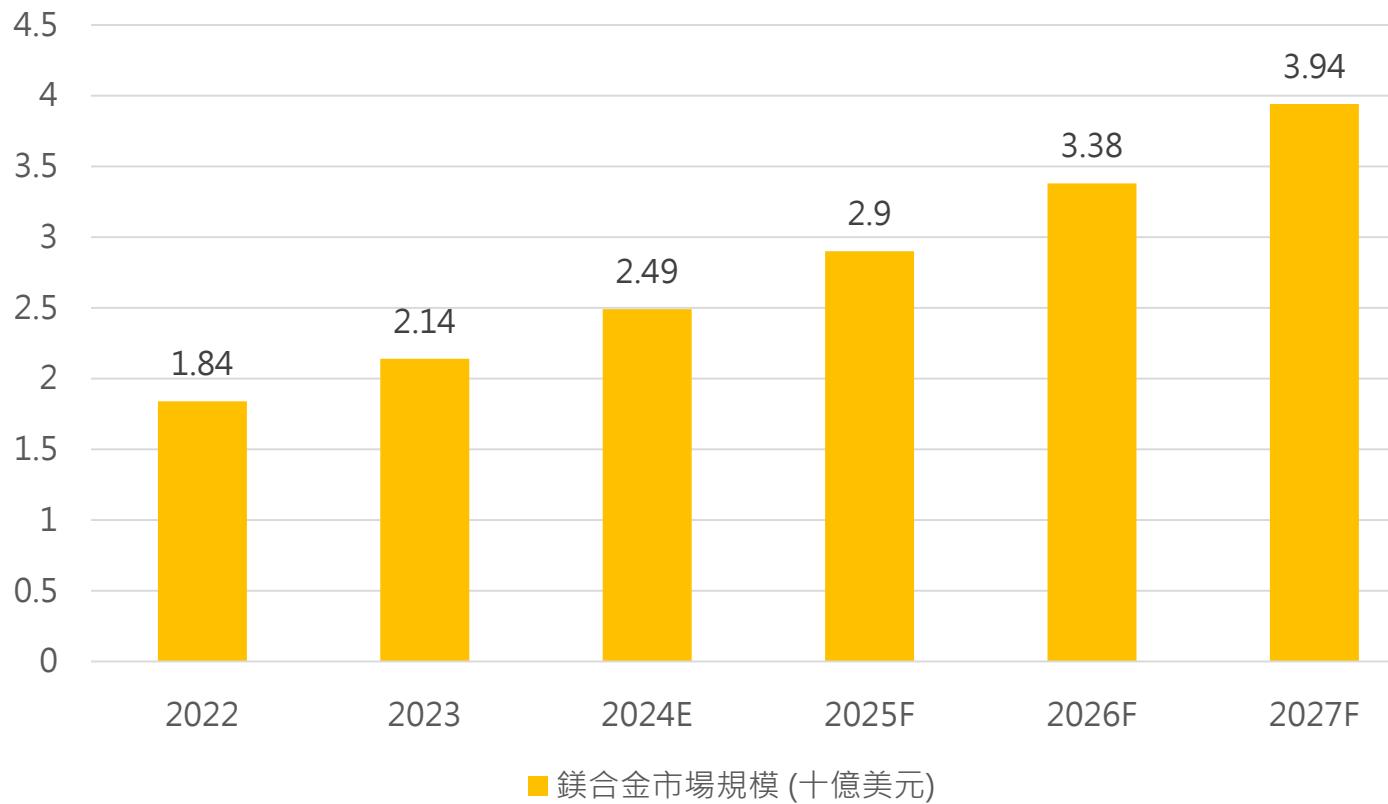


2024-2027 CAGR

+29.6%

- ✓ 隨著全球各國政府的政策推動理想的車樁比 3 : 1之下，全球公共充電樁對於充電槍的市場需求將十分可觀。
- ✓ 根據TrendForce的預估，全球2024年新增182萬個充電樁，至2027年將新增近4百萬個充電樁，2024-2027年CAGR為29.6%。

產業趨勢- 全球鎂合金市場需求

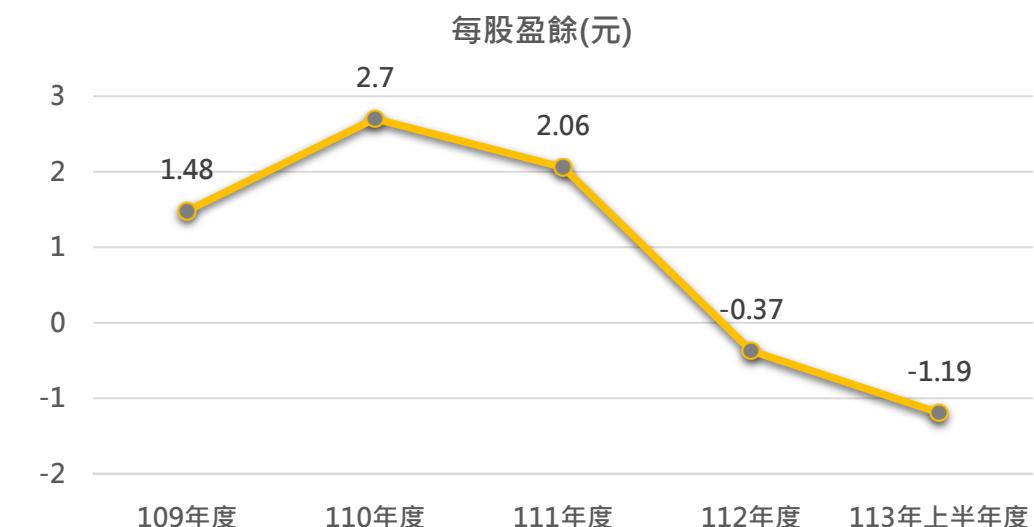
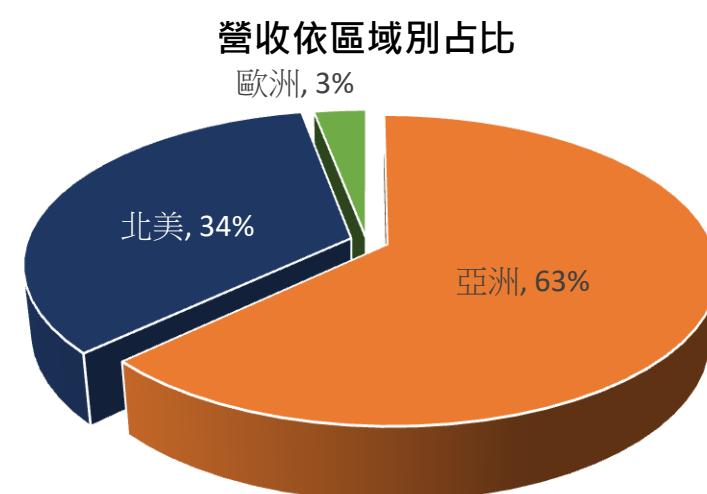
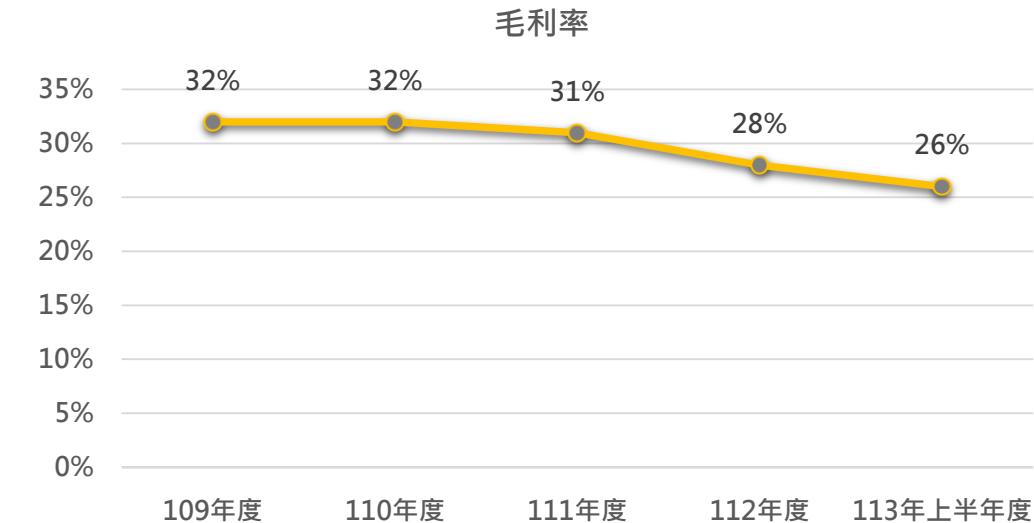
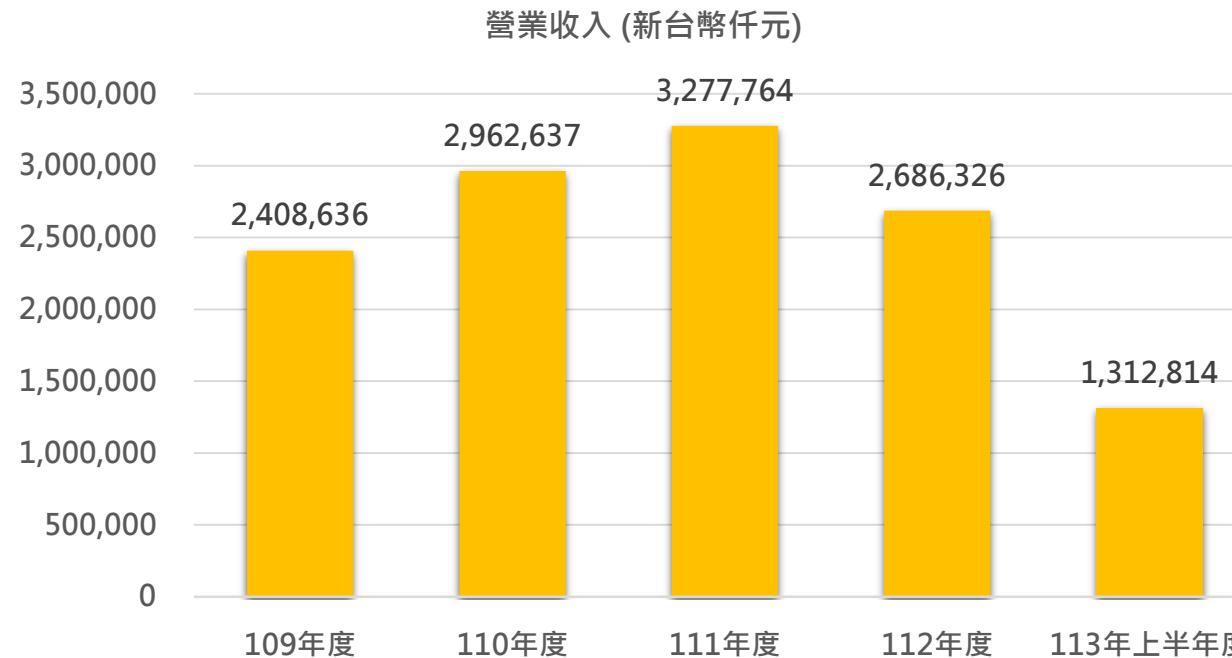


2024-2027 CAGR
+16.5%

- ✓ 2022年全球鎂合金市場規模為18.4億美元，從2023年的21.4億美元預估成長到2027年的39.4億美元。
- ✓ 鎂合金市場是輕量材料和冶金的重要領域，具有低密度和高強度重量比的特性。這些合金主要由鎂組成，包括鋁、鋅和錳等元素，對汽車、航太、消費電子和醫療設備等產業非常有吸引力。

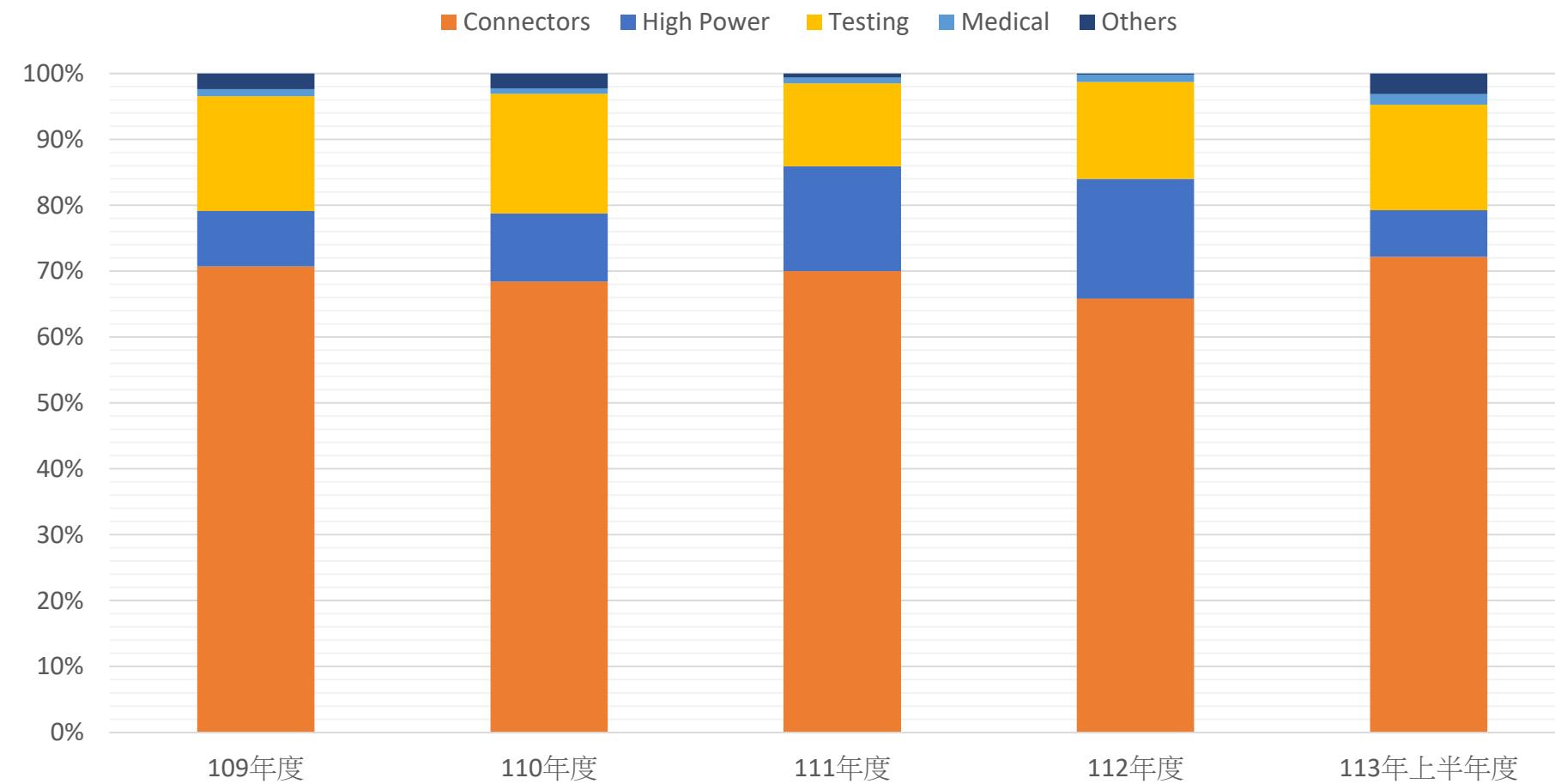
經營績效

營收狀況



產品線收入占比

產品線收入占比 (近5年)





未來展望

未來展望 - 高功率老化測試(High Power Burn-in Socket)

2023

2024

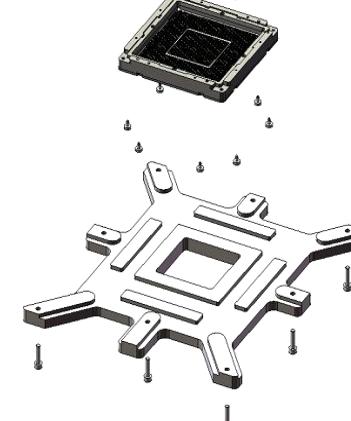
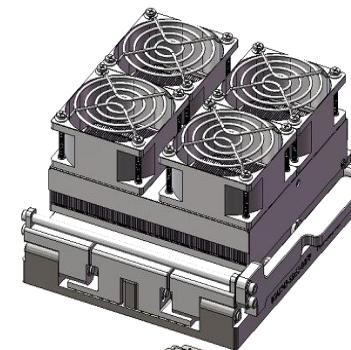
2025

AI人工智能晶片

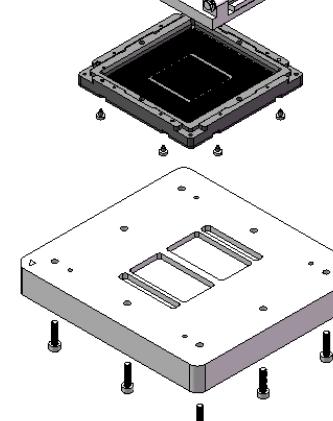
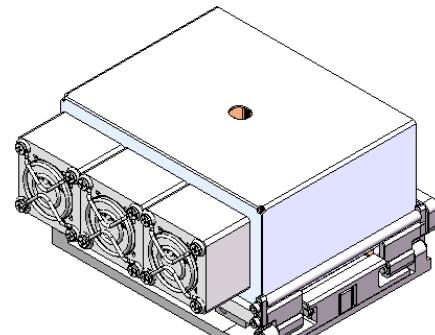
車用功率元件晶片

高速通訊晶片

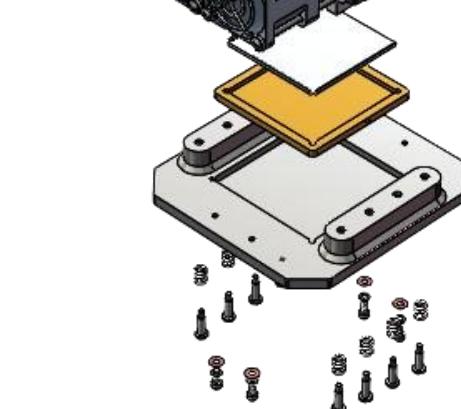
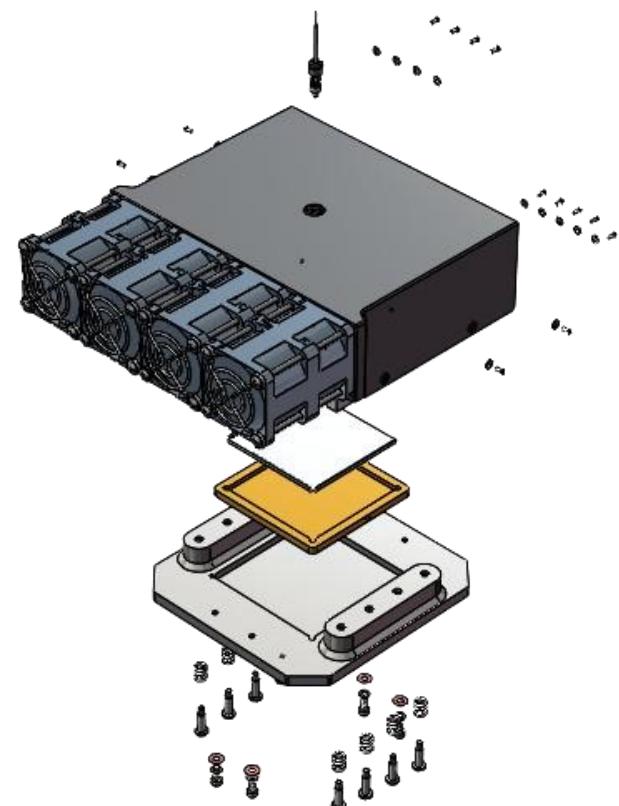
自動化設備晶片



500W



800W



1200W

微型化與精密化

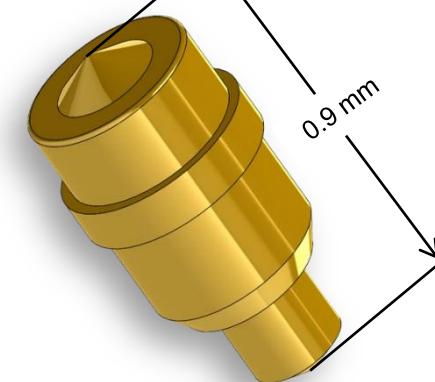
極端環境高可靠性

異材質進鍍層技術

高速高頻線束模組

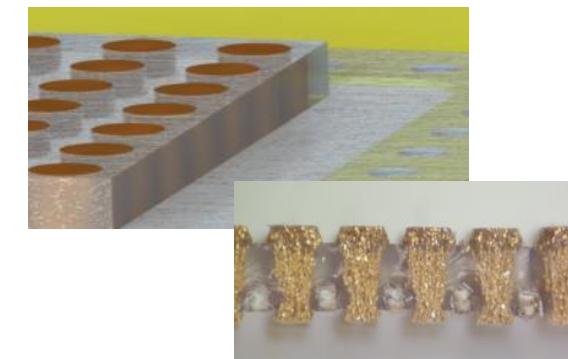
2024

Ultra Short Probe



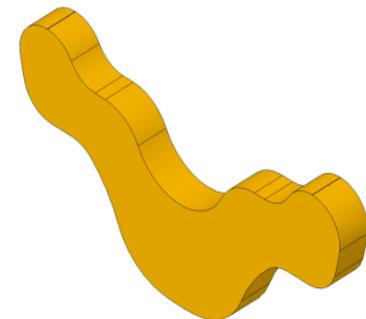
2025

PCR

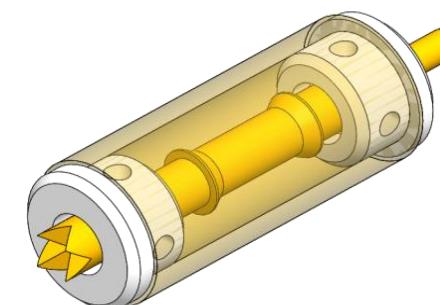


2026

MEMS



Coaxial Module



RF Module



224Gbps Hyper Socket

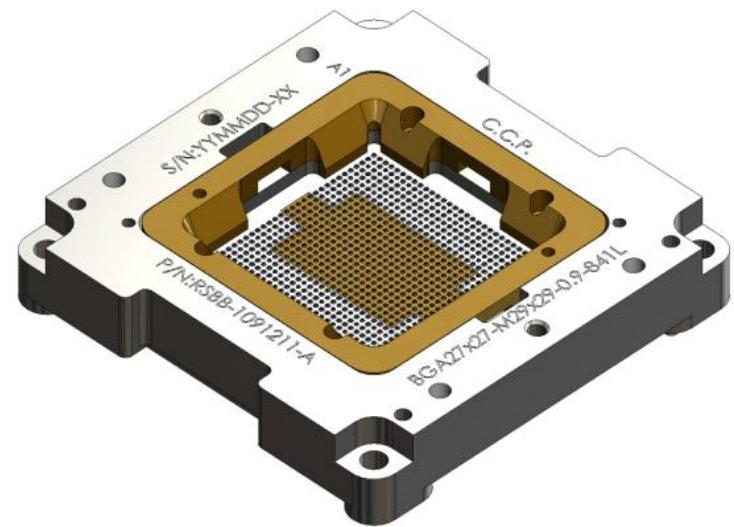
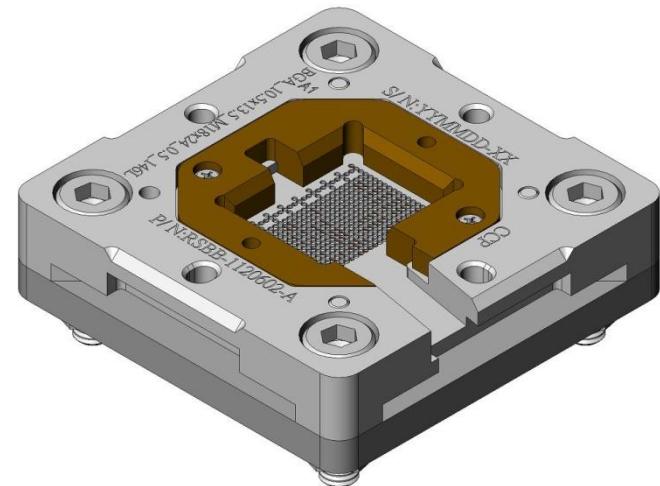
高頻同軸測試

數據中心與伺服器

雷達衛星通訊

智能手機無線設備

基地台與通訊設備

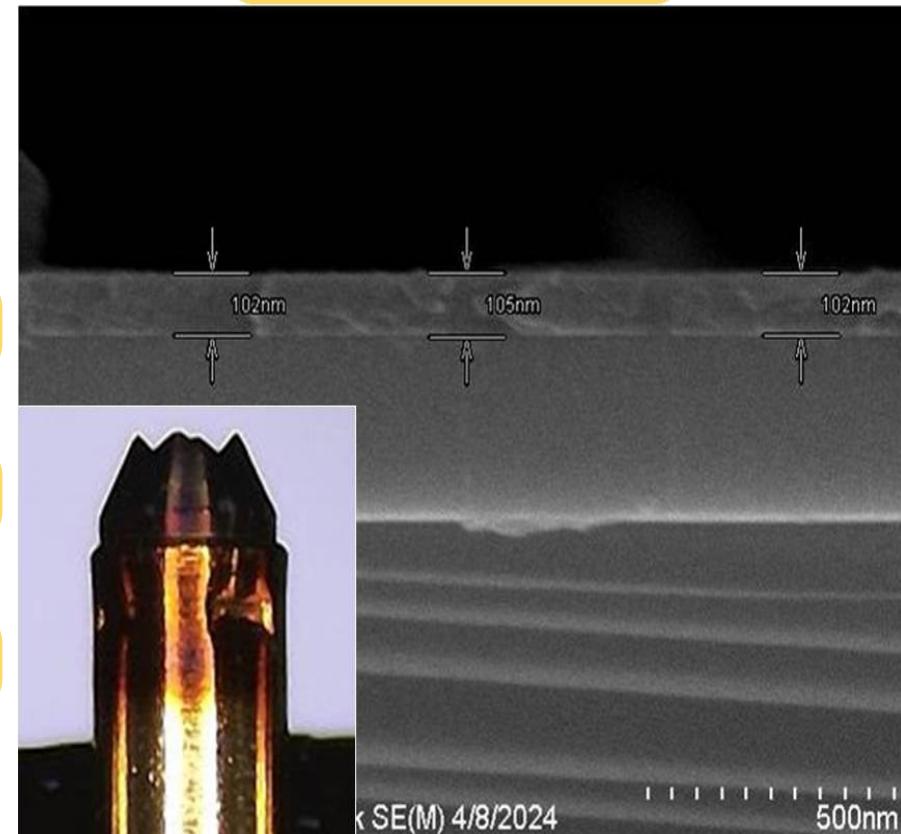


低沾黏

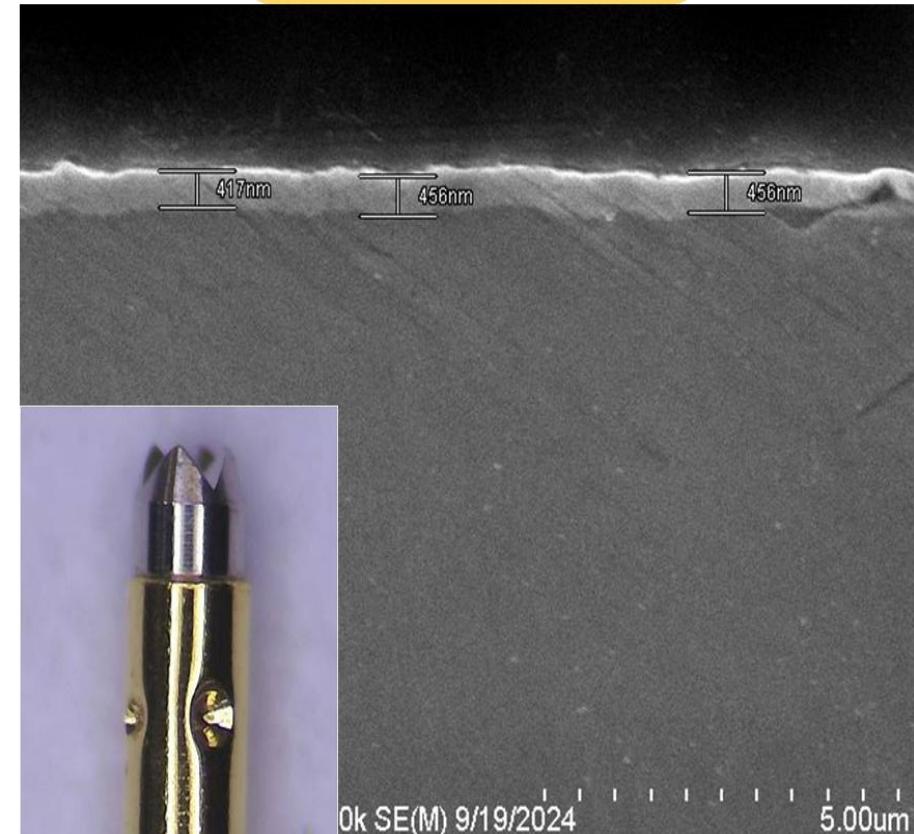
低接觸電組

高測試使用壽命

DLC



GA



鎂合金材料應用

材料賦能

筆記型電腦外殼



車用電子設備



伺服器設備應用

航天航空應用



CCP Contact Probes

Thanks for listening

info@pccp.com.tw

www.ccprobes.com

